

数字で見る

米国ユタ州リーハイで計画が進む TI の時期300mmウェハーファブ

110 億ドル
の投資

米国ユタ州
最大規模の投資

TI で約 **800** 人
の新規雇用

2023 年下期
建設開始予定

2026 年上期
製造開始予定

毎日数千万個の
アナログおよび組み込みチップが
製造されます

LEED Gold 規格に
適合する設計

既存のファブに比べて 2 倍
近くに達する水のリサイクル

Alpine School District (アルパイン学区) に
万ドルを投資する見込み

900



TI は次世代を担う半導体製造施設を
米国ユタ州リーハイで建設中

TI.com/Lehi (<https://news.tij.co.jp/ja-jp/news-releases/content-id-127868>)
をご覧ください